

PG 300WT 矽晶圓厚度量測儀

PG300WT 是由Pegasus最新研究開發的一款半導體矽晶圓厚度的測量設備。該設備採用了高精度非接觸電容式探頭,可對樣品進行無損及快速的厚度測量。通過觸控面板控制及設定參數,設備內建軟體可計算多點厚度,及TTV等功能。

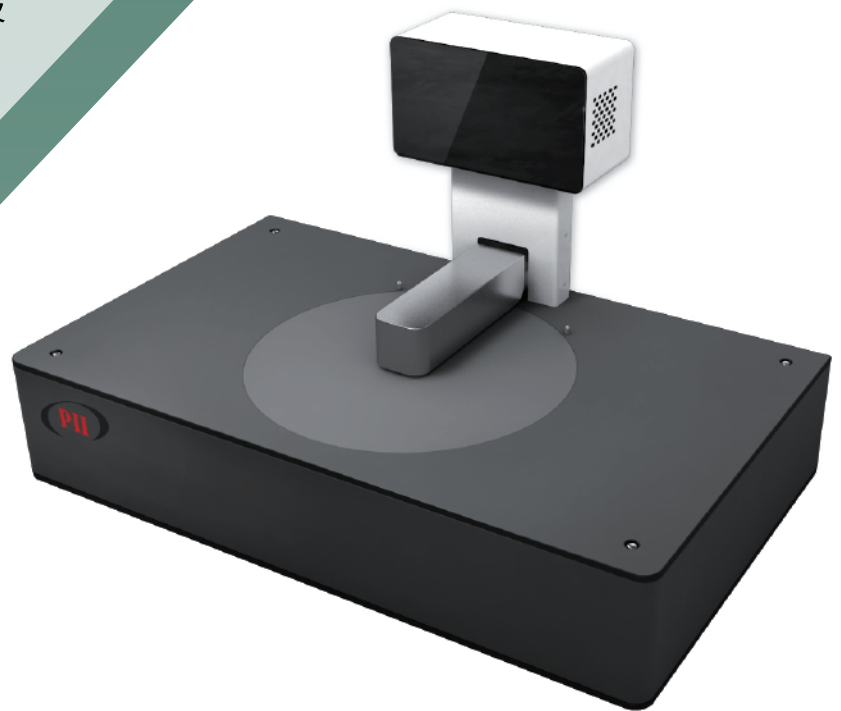
特點:

- 觸控面板操作,並顯示測量結果
- 支援多點TTV及厚度量測功能
- 可量測晶棒切片,蝕刻片,研磨片,拋光片及帶有圖形的矽晶圓
- 無需無塵室等級即可操作量測
- 桌上型設計,俐落且便於操作

主要測量材料:

- 矽晶圓 Si
- 碳化矽 SiC
- 鍺 Ge
- 磷化銦 InP
- 砷化鎵 GaAs
- 氮化鎵 GaN

PG300WT手動 矽晶圓厚度量測儀



設備規格

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • 厚度測量範圍 : 150um to 1000um | • 測試樣品尺寸 : 75mm to 300mm |
| • 精度 : ±0.5um | • 重複性 : ±0.5um |
| • 解析度 : 0.1um | • 探頭量測直徑 : 5mm |
| • 操作方式 : 觸控螢幕 | • 尺寸 : 389mm*374mm*365mm |